



Micro-Slice（微型切片）是一种应用于各种材料的高科技技术。其用于碳纤脚板，目的是使脚板在具有一定弹性的同时，又不损失强度，从而达到更好的储能和释能功效。

[产品说明]

它的设计不同于两层弹性板组成的假脚，而是增加了创新的第3层弹性板，这一设计理念贯穿于整个步态周期的每个阶段 - 从足跟触地、支撑中期、到蹬离期。从而使脚板在完整的步态周期都具有无与伦比的流畅、稳定及功能性。

[主要特点]

- 独特的三层结构
- 行走时滚动流畅且超级稳定
- 调整足跟楔块来精确定足跟硬度
- 创新的“微型切片”技术使脚板具有万向功能
- 结构高度低
- 重量轻

[技术参数]

- * 最大承重：136 公斤
- * 脚板尺寸：22-30 厘米
- * 重量：260 克（24 号脚板）
- * 结构高度：9.5 厘米

